



Рис 3. Мікрофотографії вільних поверхонь торцевого перерізу електроосаджених прошарків міді зразків: а) 1, б) 2, в) 3, г) 4, д) 5.

Fig. 3. Micrographs of the free surfaces of the end section electrodeposited copper layers on samples: a) 1; b) 2; c) 3; d) 4; e) 5.